



VP800

蒸汽式焊接系统

- 适用于实验室，试制样品和模拟生产工艺验证

ASSCON 蒸汽回流焊接系统是当今最先进的技术，它以创新方法应对现代装配对焊接技术的挑战。特殊工艺原理使它能轻松应对几乎所有最复杂的表面贴装组件在无铅环境下焊接。

ASSCON VP800 焊接系统特别为实验室和样品试制而设计。由于采用多功能工艺室架构，机器亦可以应用于生产前模拟工艺验证，以及小批量生产作业。

机器设计

因为机器的工艺区与冷却模块相互分离，独立的 VP800 焊接系统可以紧凑地安装在现有的生产线中。在这里，系统尤其突出其操作简便的优点，每个用户都可以轻易地焊接出高品质的组件。

VP800 系统前面是一个带门锁机构的焊接件进出口，大尺寸的电路板亦可以放入焊接区，有效扩展了系统的应用范围。



机械系统结构非常简单，设计时充分考虑到作业人员操作的舒适性，可轻松进行操作和维护保养。

作为选配组件，可以为 VP800 配备液体过滤系统。在过程启动时导热媒质经过滤并进入系统循环中。

标准的 VP800 连接外部循环冷却水系统。客户亦可以选择由 ASSCON 提供与之配套的闭环冷却系统。

工艺顺序

待焊接电路板通过前面的入口装载到系统内，焊接程序启动。

焊接件进入系统后，电动马达将载板下降至焊接区指定高度。蒸汽开始加热，PLC 根据预设的升温斜率参数进行监控。

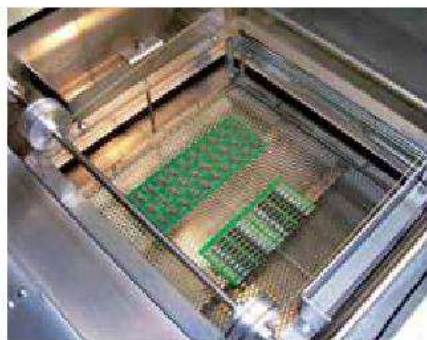
机器自动侦测完全熔锡后，工作载板上升至冷却区，冷却风扇开始工作，致使电路板冷却和导热媒质完全蒸发。冷却结束后，机器提示焊接过程结束，等待下次生产过程的开始。



VP800
with closed external
cooling system (optional)

技术优势

因为利用液体和蒸汽作为能量传导媒质，其热导率远远高于普通的热风对流工艺。使用一种特殊的导热液体 GALDEN®，当预热开始时，蒸汽便凝结于工件表面，焊接件被包裹在液体和蒸汽所创造的惰性环境中。因而在整个预热和焊接过程都处于无氧环境。



由于可以控制升温斜率，对应于不同焊件的热量需求，系统会自动调节产生其焊接所需的蒸汽量。这样即使热容量差异很大的零件亦可

有效地保证整个组件的均温性。整个基板的温差接近零度。

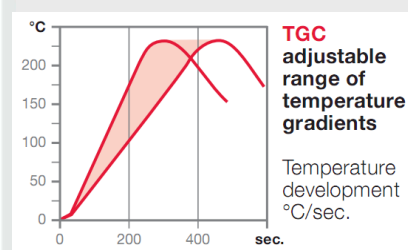
永远不会发生基板过热而导致元件或 PCB 的损坏，最高焊接温度不会超过导热媒质 GALDEN® 的沸点。

典型应用

- 实验室应用，测试和验证焊接工艺
- 制定焊接温度曲线
- 可靠焊接单件 SMT 电路板
- 模拟生产工艺验证
- 小批量生产应用
- 锡膏和基板的质量分析
- SMT 不良元件返修，可完成元件拆除和再焊接，是传统返修台的最佳替代

VP800 工艺一览：

- 智能回流焊接系统
- 连接外部循环冷却水系统
- 自动媒质识别
- 方便调节升温斜率
- 可方便连接测温仪
- 无氧工艺，无氧预热和焊接
- 完全适用于无铅工艺
- 可选配导热媒质过滤系统
- 可选配闭环冷却系统



最佳的工艺可靠性：

- ASB (自动侦测熔锡)，自动监测焊接过程是否完成
- TGC (温度斜率控制)，调整预热过程的升温斜率
- OPC (可视工艺控制)，工艺过程可视化。

技术数据

| | |
|---------|----------------------------|
| 最大焊接件尺寸 | 400 x 400 mm |
| 最大焊接件高度 | 85 mm |
| 电力供应 | 400 V / 3 / PE / N - 50 Hz |
| 耗电量 | 4,1 kW |
| 媒质容量 | 15 kg |



旭義普国际贸易（上海）有限公司
SIP Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Co. Reg. No.: 773266871

上海市黄浦区汉口路 515 号，汇金大厦 1211 室，邮编：200001

No.515, Han Kou Road, Hui Jin Tower, Unit 1211, Shanghai 200001, P.R.China

Tel: +86-21-6322-2561 / 6360-5822

Fax: +86-21-6322-6772